

证券代码：688260

证券简称：昀冢科技

公告编号：2026-044

苏州昀冢电子科技股份有限公司
关于控股子公司签署招商协议书暨设立项目公司实施
高性能多层片式陶瓷电容器生产项目的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资概述

苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月24日、2026年7月10日召开第三届董事会第七次会议、2026年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司签署招商协议书暨设立项目公司实施高性能多层片式陶瓷电容器生产项目的议案》，同意公司控股子公司池州昀冢电子科技有限公司（以下简称“池州昀冢”）与皖江江南新兴产业集中区管委会签署《高性能多层片式陶瓷电容器生产项目招商协议书》，并通过设立项目公司池州昀池电子有限公司（以下简称“项目公司”或“池州昀池”）为实施主体，投资高性能多层片式陶瓷电容器生产项目（以下简称“本项目”）。具体内容详见公司分别于2026年6月25日、2026年7月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股子公司签署招商协议书暨设立项目公司实施高性能多层片式陶瓷电容器生产项目的公告》（公告编号：2026-037）、《2026年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2026-043）。

二、交易事项进展情况

（一）项目公司登记注册情况

近日，本项目实施主体池州昀池已完成工商登记注册手续，并取得了皖江江南新兴产业集中区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

- 公司名称：池州昀池电子有限公司
- 统一社会信用代码：91341700MAKJ4F9G12
- 注册资本：伍佰万圆整
- 类型：其他有限责任公司

5、成立日期：2026 年 7 月 12 日

6、法定代表人：刘星星

7、住所：安徽省池州市江南产业集中区乐山路以西汉江路以北昀冢 2 号厂房

8、经营范围：一般项目：电力电子元器件制造；电容器及其配套设备制造；电子元器件制造；电子专用设备制造；光电子器件制造；光电子器件销售；其他电子器件制造；电子元器件批发；电子专用材料制造；电子真空器件制造；电子元器件零售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（二）协议签署情况

截至本公告披露日，池州昀冢与皖江江南新兴产业集中区管委会就本项目签署了《高性能多层片式陶瓷电容器生产项目招商协议书》，池州昀池、池州昀冢与池州江南新兴产业基金合伙企业（有限合伙）就本项目首期增资签署了《池州江南新兴产业基金合伙企业（有限合伙）关于池州昀池电子有限公司之增资合同书》，协议主要条款与此前披露的内容保持一致。

三、对公司的影响

本项目的实施能够有效缓解产能制约，充分承接下游增量订单，巩固公司 MLCC 业务市场竞争力，持续做大业务规模、提升盈利水平，夯实公司中长期业务发展根基。本项目的实施短期内会增加公司资本开支和现金支出，但长期可助力公司夯实业务布局、提升经营水平，适配后续业务扩容及市场开拓规划，与公司发展战略相契合，将为企业长远可持续发展奠定坚实基础。未来该项目的实施有望提升公司盈利水平，改善公司整体经营效益。

四、风险提示

（一）本项目的实施存在不确定性，如因经营环境、市场需求等方面的影响，项目可能存在延期、变更或终止的风险。

（二）本项目的资金来源为自有及自筹资金和第三方对项目公司的增资款，各期资金能否按照计划节点足额到位存在较大不确定性。若资金到位进度不及预期，将延缓项目投入，导致项目无法按计划推进。项目投资过程中的资金筹措、

信贷政策的变化，如影响项目实施进度，将不利于公司业务的发展。

（三）本项目的资金筹措周期较长，首期投资额预计于 2028 年 9 月之前分批投入，可能存在较大比例的资金到位时点相对靠后，项目开工、投产等关键节点高度依赖资金拨付进度。若出现市场融资条件收紧、出资人资金计划发生变动、经营效益存在下行压力等情形，可能出现相应批次资金未能按时拨付的情况，从而导致投资项目阶段性资金不足，进而导致项目实施进度滞后，出现投资效益不及预期的风险。

（四）本项目具有技术壁垒高、研发难度大等特点，下游终端客户准入标准严苛，产品全流程可靠性验证环节繁多，特殊应用领域认证周期跨度较长，存在认证进度不及预期、无法顺利导入批量供应链的风险。本项目经营效益受宏观经济、下游市场发展态势、公司产品竞争力、客户认可程度等多种因素影响，具有较大的不确定性。

（五）本项目实施后的财务费用、折旧摊销、现金流流出对公司的财务影响较大。如项目不能如期产生效益或实际收益低于预期，则可能会对公司财务状况产生一定不利影响。

（六）本项目的投产时点具有较大不确定性，短期内可能难以充分释放产能、兑现经营效益，存在一定时期内无法有效改善公司基本面的风险。项目投资过程中的产能爬坡、产能释放受设备购置与安装调试、工艺优化、原材料供给等因素影响，全过程存在不确定性，存在产能爬坡缓慢、产能释放不及预期等风险。项目实施节奏将综合行业市场环境、项目运营效益测算等多重因素动态统筹，公司存在依据市场供需变化、项目实际运营状况，对项目投资进度、投资安排及投产计划等相关方案进行调整的情形。项目投产后，若行业需求下行、市场拓展不及预期、新增产能无法充分消化，将导致项目投资回报不及预期，存在业绩承压的风险。

（七）本项目的所需资金规模较大，资金来源为公司自有及自筹资金和第三方增资款。截至 2026 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 87.35%，处于较高水平。本项目的实施可能进一步抬升公司资产负债率，加大公司财务杠杆与偿债压力。虽本次项目投资依托行业良好发展前景开展，具备中长期业务增长支撑逻辑，但项目推进周期、资金筹措进度、经营效益实现情况均存在不确定性。若后续市场环境、项目运营不及预期，或公司融资渠道、现金流状况发生不利变化，将可能

对公司财务状况、流动性水平及经营业绩产生较大不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日